

Broadcom a TSMC zvažují dohody s Intelem, které by mohly vést k jeho rozdělení, uvádí WSJ

17.2.2025 - Michal Šnobl | Fio bank

Tchajwanská TSMC a americký Broadcom zvažují investici do Intelu, která by mohla vést k jeho rozdělení, uvedl v sobotu Wall Street Journal s odkazem na obeznámené zdroje.

TSMC uvažuje o koupi části nebo všech továren Intelu na výrobu čipů, případně ve spolupráci s investičním konsorciem. Mezitím Broadcom zvažuje nabídku na divizi návrhu čipů a marketingu, ale hledá partnera pro výrobní část podniku, uvádí zpráva.

Jednotlivé strany na potenciálních akvizicích nespolupracují a jednání jsou zatím v rané fázi, dodává WSJ.

Problémy Intelu začaly poté, co zaostal za TSMC v pokročilé výrobě čipů a nepodařilo se mu realizovat transformační plán CEO Pata Gelsingera před jeho odvoláním v prosinci. Společnost nyní odděluje svou výrobní divizi, což naznačuje možný rozpad, uvádí zpráva.

Administrativa Donalda Trumpa pobídla TSMC k úvahám o dohodě, ale podle vyjádření představitele Bílého domu je nepravděpodobné, že by prezident podpořil zahraniční kontrolu nad továrnami Intelu, uvedl zpravodajský server.

<https://www.fio.cz/zpravodajstvi/zpravy-z-burzy/306562-broadcom-a-tsmc-zvazuji-dohody-s-intelem-ktere-by-mohly-vest-k-jeho-rozdeleni-uvadi-wsj>